型号 HPM-**-***

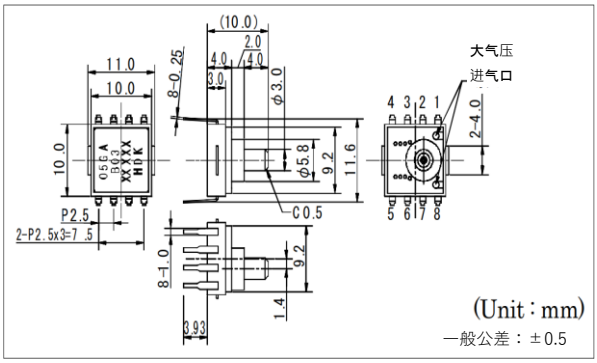
采用最新半导体工艺与微加工技术制造的压力传感器，具备高灵敏度与高精度特性，可满足各类用户需求。同时能灵活应对定制化产品需求。

■特征

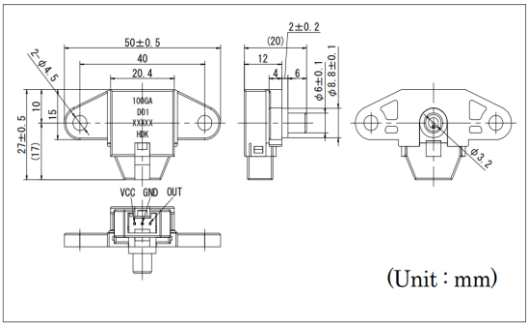
·模拟输出
·内置EEPROM实现多种数字校正，确保高精度与高稳定性
·低功耗：最大2mA
·离散式结构，法兰安装连接器式

■外形尺寸

离散型： HPM-**-B**




法兰安装连接器类型： HPM-**-D**




一般公差：±0.3

■基本规格

| 项目 | 额定值 | | 单位 |
|---|---|---|---|
| 型号 | HPM - ** - B ** | HPM - ** - D ** | |
| 形状 | 离散型 | 法兰安装连接器类型 | |
| 输出形态 | 直流 | | |
| 绝对最大额定值 | | | |
| 输出形态 | 表压 | | |
| 压力介质 | 水、空气、其他非腐蚀性介质 | | |
| 最大施加压力 | 额定值的2倍 | | kPa |
| 保存温度范围 | -40～85 | | ℃ |
| 精度保证温度范围 | -10～60 | | ℃ |
| 电源电压 | 5 | 5 或 12 | V |
| 条件·电气特性 | | | |
| 压力范围 | -90～1000（可在上述压力范围内定制） | | kPa |
| 输出 | 0.5～4.5（基本范围） | | V |
| 输出精度 | ±2 | | %FS |
| 压力线性度 | ±0.5 | | %FS |
| 压力迟滞 | ±0.3 | | %FS |
| 消耗电流 | 2.0Max | | mA |

※可根据上述基本规格定制（如不同压力范围等）。

■型号构成

HPM - ** G A - B **

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①：压力传感器模块「HPM」
②：压力满量程范围
③：压力类型「G：表压」
④：模拟输出
⑤：外形
(B：离散型、D：法兰安装连接器型)
⑥：定制型号


※本产品目录内容可能未经预告进行变更。且并非包含所有信息。特别是安全设计方面，请通过交换交货规格书进行确认，同时请确认贵方设计的电路或整套设备的安全性。